

第2号議案

令和3年度事業報告

I 事業報告 総括

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症により、海外への渡航制限やリアルな活動の制約を受けたことで中止せざるをえない事業があったものの、会員各位のご協力や情報機器の活用により、年間を通じて当初計画に基づいた事業運営が行えた。

事業運営にあたっては企画委員会が中心となって事業計画を策定し、グローバルイノベーション・グローバルマーケティング・グローバルネットワークの3つの専門部会が主体的に各事業に取り組んだ。

主な事業は次のとおりである。

- 研究開発事業では、グローバルニッチトップ推進事業として公募。これまで培ってきた自社の強みを活かし、自社にとっての新分野への事業展開や、自社の強みを更に高めるための製品競争力の強化を目的とした開発事業に対して、支援を実施した。
- 人材育成事業では、継続開催している半導体基礎講座を技術基盤として実施した。また、新分野・成長分野参入に直結した技術力を習得できるよう、首都圏開催の系統的な技術研修会を大分にて開催、当会員の技術力の向上をはかった。
- 販路開拓・情報提供事業では、セミコンジャパン・アジア最大級展示博覧会であるネプコンジャパンに出展し、当会員の紹介及び当会PRを行った。また、台湾企業との商談会は新型コロナウイルス感染症のため、熊本県と連携し、春・秋の2回オンラインで開催した。
- 会員交流事業では、トップセミナーを開催し、経営へ寄与すると共に会員相互の交流によるネットワークの強化を図った。これまでの技術者交流会に代わり、対象を広くした会員交流会を対面にて開催する計画であったが、オンラインでのセミナー開催とした。
- 総会にあわせてフォーラムを開催し、日本が誇るパワー半導体への期待と機会や、6月政府公表の「半導体・デジタル戦略」について、いち早くその概要を聴講、我が国の半導体業界の今後を会員が認識できた。
- 平成30年度発行した、『災害時における相互協力に関する合意書』については、合意書会員登録がさらに増加し24社となり、BCM活動の更なる定着がはかれた。
(初版17社)

II 新スローガン・ビジョン策定

世界半導体市場は拡大基調であり、かつ半導体は経済安全保障に位置付けられたことにより、6月政府から半導体業界への取組強化として「半導体・デジタル戦略」が公表された。このような大きな変革に対応するために、今後の当会事業運営の指針として、新たな「スローガン・ビジョン」を企画委員会にて検討、理事会にて決定した。

新スローガン：

『 未来を拓く 産業モデルの創出 ～ 想いをカタチに 共感で広げる ～ 』

Ⅲ 事業報告

1. 理事会・専門部会等の開催

「おおいたLSIクラスター中期ビジョン」の実現に向けた事業計画等を協議し推進するため、理事会、企画委員会と、グローバルイノベーション・グローバルマーケティング・グローバルネットワークの3つの専門部会及びグローバルニッチトップ推進事業の審査会を開催した。

(1) 理事会

①第1回理事会

日時：令和3年5月25日(火) 15:00～15:50

場所：大分県産業科学技術センター 多目的ホール

議題：
・令和2年度事業報告
・令和2年度収支決算報告
・令和3年度事業計画 ほか

②第2回理事会

日時：令和4年3月15日(火) 15:00～16:10

場所：大分県産業科学技術センター 多目的ホール

議題：
・令和3年度収支予算の補正
・スローガン・ビジョンの見直しについて
・令和4年度事業計画及び収支予算
・令和3年度事業進捗状況報告 ほか

(2) 企画委員会

①第1回企画委員会

日時：令和3年4月13日(火) 15:30～17:00

場所：大分県庁舎 本館 71会議室

②第2回企画委員会

日時：令和3年6月17日(木) 15:00～17:00

場所：大分県産業科学技術センター 第1研修室

③第3回企画委員会

日時：令和3年8月3日(木) 15:00～17:00

場所：大分県庁舎 本館 71会議室

④第4回企画委員会

日時：令和3年10月28日(木) 15:00～17:00

場所：大分県庁舎 本館 71会議室

⑤第5回企画委員会

日時：令和3年12月2日(木) 15:00～17:00

場所：大分県庁舎 本館 71会議室

⑥第6回企画委員会

日時：令和4年2月1日(木) 15:00～17:00

場所：オンライン

⑦第7回企画委員会

日時：令和4年3月1日(火) 15:00～17:00

場所：大分県庁舎 本館 防災活動支援室1

(3) 専門部会

[グローバルイノベーション部会]

- ①日 時：令和3年6月10日(木) 15:00～16:00
場 所：オンライン
- ②日 時：令和3年10月14日(木) 15:00～16:30
場 所：大分県産業科学技術センター 第1研修室
- ③日 時：令和4年2月10日(木) 15:00～16:40
場 所：大分県産業科学技術センター C201会議室

[グローバルマーケティング部会]

- ①日 時：令和3年6月10日(水) 10:00～11:00
場 所：オンライン
- ②日 時：令和3年11月9日(火) 15:00～16:00
場 所：大分県産業科学技術センター 第1研修室
- ③日 時：令和4年2月3日(木) 15:00～16:30
場 所：オンライン

[グローバルネットワーク部会]

- ①日 時：平成3年6月8日(火) 10:00～11:00
場 所：オンライン
- ②日 時：令和3年8月24日(火) 15:00～16:05
場 所：オンライン
- ③日 時：令和3年10月12日(火) 15:00～16:10
場 所：大分県産業科学技術センター 第1研修室
- ④日 時：令和4年2月9日(木) 15:00～16:20
場 所：オンライン

(4) グローバルニッチトップ推進事業審査会

- ①日 時：令和3年5月28日(水) 13:00～17:30
場 所：大分県産業科学技術センター

2. 総会・フォーラムの開催

日 時：令和3年7月9日(金) <講演会>14:00～17:10

場 所：レンブラントホテル大分

参加者：99名(47団体)

- 内 容：①主催者挨拶 大分県知事 広瀬 勝貞
大分県LSIクラスター形成推進会議 会長 森 重哉
- ②来賓紹介及び挨拶
九州経済産業局 地域経済部長 佐藤 二三男 氏
九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会
会 長 安田 幸央 氏
- ③「おおいたLSIクラスター」事業報告
大分県LSIクラスター形成推進会議 企画委員長
大分県LSIクラスター形成推進会議 各専門部会長
- ④基調講演
『カーボンニュートラルに向けた パワー半導体への期待と機会』
講師 三菱電機株式会社パワーデバイス製作所 所長 安田 幸央 氏
- ⑤特別講演
『半導体・デジタル産業戦略』
講師 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課長 西川 和見 氏

3. グローバルイノベーション事業の実施

(1) グローバルニッチトップ推進事業

これまで培ってきた自社の強みをいかし、自社にとって新分野への事業展開（ニューマーケット進出事業）や、自社の強みを更に高めるための製品競争力の強化（ニッチトップ創出事業）を目的とした開発事業に対して補助金を交付した。

成果報告会を開催し、各事業の成果を確認するとともに、より効果的な事業とするためアドバイスを行った。また、過去の採択案件についても適宜サポートを行った。

※審査員はハイブリッド対応。

・ニューマーケット進出事業

- ①デジタルマーケティング導入による新規市場開拓
- ②草木染アルミニウム&マテリアル事業
- ③協働ロボットインテグレータ事業

・ニッチトップ創出事業

- ①負荷急変特性改善電源開発
- ②ELID 研削システム導入による鏡面研削加工の高精細化と生産性向上

(2) 技術者研修会

ビジネスチャンス獲得に向け、半導体の最新技術や新たな成長分野をテーマにした技術者研修会（技術者塾）を開催した。

①技術者塾Ⅰ

テーマ：品質管理セミナー

“失敗談から学ぶトヨタ必須の17の品質管理手法”

日時：令和3年7月27日(火) 10:00～16:45

場所：大分県産業科学技術センター 多目的ホール

講師：株式会社ワールドテック 皆川 一二 氏

参加者：13社2機関 35名

②技術者塾Ⅱ

テーマ：課題解決のためのデータ分析入門

日時：令和3年10月19日(火) 13:00～17:00

方式：オンライン講座

講師：データ&ストーリーLLC 代表 柏木 吉基 氏

参加者：16社1機関 66名

③技術者塾Ⅲ

テーマ：新商品アイデア、ビジネスチャンスの発見に必須の「ジョブ理論」

日時：令和3年11月30日(火) 13:00～17:30

方式：オンライン講座

講師：株式会社インディージャパン

組織開発・事業開発ディレクター 星野 雄一 氏

参加者：20社 28名

④技術者塾Ⅳ

テーマ：データ分析活用（標準編）

日時：令和4年3月4日(火) 10:00～16:00

方式：オンライン講座

講師：データ&ストーリーLLC 代表 柏木 吉基 氏

参加者：18社 57名

(3) 基礎教育・新人教育の充実

半導体基礎講座

会員企業の新任技術者等を対象にした半導体基礎講座を、(株)エリアへの業務委託により実施した(コース3回)。これまで会員協力により工場見学を行っていたが、コロナ対策として受入が難しく、今年度は座学のみとした。

日時：令和3年7月14日(水)、21日(水)、28日(水) 13:30~16:30

方式：オンライン講座(大分県産業科学技術センター C201号室配信)

受講者：14日-16社2機関 37名、21日-22社2機関 47名
28日-16社2機関 44名

(4) 「学」との連携・広域連携

1) 学生による会員企業見学会

大分高専との連携の一環として、高専生の県内会員企業見学会を実施。会員企業(中小企業)の活動を知ってもらい、大分県内のものづくり企業に対する理解を深めてもらうことを目的として開催した。

日程：令和3年12月22日(水)

概要：県内会員企業2社訪問

企業概要・事業展開の説明、職場見学、OBとの交流

参加者：大分高専 学生43名、教諭2名

2) 大学・高専連携推進補助事業

産学連携強化を目的に大分大学・大分高専との卒論テーマを会員企業課題として、共同研究を実施、その研究費の補助を行った。

■大分大学

①バーンインソケット内IC着座検査精度向上

②配線支援アプリケーションの開発

■大分高専

①半導体テスト装置部材の熱接触抵抗の改善

②パワー半導体の接合部電界特性の検討

4. グローバルマーケティング事業の実施

(1) 海外ビジネス交流事業

今年度は、海外渡航も困難であり、台湾・中国とのリアルな相互交流は断念した。

台湾交流として、熊本県工業連合会、九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会と連携してオンラインでの商談会を開催した。

当会・熊本県工業連合会・台湾電子設備協会、3団体主催にて、大分県・熊本県・台北の3会場でオンライン商談会を開催した。

①台湾との交流-1

商談会(大分会場)

開催日：令和3年4月22日(木)

場所：レンブラントホテル大分 二豊の間

参加企業：大分LSI 9社参加(内1社は台北会場にて参加)

大分 計31商談

熊本会場 9社参加

台北会場 25社参加

②台湾との交流-2

商談会(大分会場)

開催日：令和3年10月5日(火)

場所：レンブラントホテル大分 二豊の間

参加企業：大分LSI 8社参加（内1社は台北会場にて参加）
大分医療IT1社、SIIQ会員1社
大分 計28商談
熊本会場 11社参加
台北会場 18社参加

（2）展示会への出展

①セミコンジャパン2021

半導体関連国際展示会である「セミコンジャパン2021」に、熊本県と合同で九州パビリオンとして出展した。九州パビリオンの中で会員企業1社と「クラスターブース」を形成して「おおいたLSIクラスター」の会員企業の新技術・新製品等の情報を発信した。

開催日：令和3年12月15日(水)～17日(金)

場 所：東京ビッグサイト 東ホール

出展小間数：8小間（当会3小間）

出展内容：クラスターブースを会員9社がパネル・サンプル展示で活用。

ブース来場者：クラスターパンフレット、会員パンフレット 各150部配布

②第36回ネプコンジャパン

エレクトロニクス開発・製造・検査に関するアジア最大級の専門展である「ネプコンジャパン」に出展した。今年度は会員企業1社、福岡県ロボット・システム振興会議と合同で九州パビリオンとして出展、当会活動状況を紹介した。

開催日：令和4年1月19日(水)～21日(金)

場 所：東京ビッグサイト 東ホール

出展小間数：3.5小間（当会1.5小間）

出展内容：クラスターブースを会員7社がパネル・サンプル展示で活用。

ブース来場者：クラスターパンフレット、会員パンフレット 各200部配布

（3）大分県LSIクラスター販路拡大支援（大規模展示会出展事業）

新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外問わず大型展示会や移動制限のため、県内半導体関連産業の販路開拓に支障が生じている。会員企業のビジネスチャンス拡大を図る為、当会出展の展示会について以下の補助を行った。

①展示会人員派遣支援補助金【上限10万円】

目 的：セミコンジャパン・ネプコンジャパン開催時に大分県LSIクラスターブース内へ展示・参加し、自社の説明員を配置する会員を支援する。

採 択：3社

②展示会出展支援補助金【上限20万円】

目 的：セミコンジャパン・ネプコンジャパンへの展示会（オンライン含む）にコロナ対策を講じて独自ブースで出展する会員を支援することで会員企業の販路開拓を推進する。

採 択：3社

5. グローバルネットワーク事業の実施

（1）トップセミナー

会員企業の経営責任者等を対象として、さらなる資質の向上とネットワークの拡大を図ることを目的にトップセミナーを開催した。

①日 時：令和3年6月2日(水)15:00～17:00

場 所：オンライン

演 題：「ポストコロナの企業戦略 ～米国CES2021の主要テーマも踏まえて～」

講 師：株式会社日本政策投資銀行 産業調査部
産業調査ソリューション室長 青木 崇 氏

参加者：73名

②日 時：令和3年11月4日(木) 13:30～15:00

場 所：オンライン

演 題：「迫りくる気候変動問題に企業はどう立ち向かうか」

講 師：株式会社日本政策投資銀行 産業調査部
サステナブルソリューション部 課長

兼 産業調査部 産業調査ソリューション室 課長 上田 絵理 氏

参加者：44名

③日 時：令和3年12月8日(水) 13:30～16:00

場 所：オンライン

<事業創出支援事例>

演 題：「次世代事業創出に向けた人材育成方法」

講 師：ブルーイノベーション株式会社 常務取締役 那須 隆志 氏

<ものづくり企業のDX取組事例>

演 題：「自社の加工技術を新規領域へ」

講 師：株式会社星製作所 代表取締役 星 肇 氏

演 題：「自社技術を Web マーケティングにより広める方法」

講 師：テクノポート株式会社 代表取締役 徳山 正康 氏

参加者：34名 (会場 51名 Web 聴講 51名)

④日 時：令和4年2月2日(水) 15:00～17:00

場 所：レンブラントホテル大分 2階 二豊の間

※ハイブリッド開催

演 題：「SDGs 革命は半導体産業にビッグインパクトもたらす！

～100兆円産業に向けて国内外の設備投資は爆裂の勢い」

講 師：株式会社産業タイムズ社 代表取締役会長 泉谷 渉 氏

参加者：110名 (会場 31名、Web 聴講 79名)

(2) 会員間及び産学官のネットワークづくり

①会員交流会の開催

新型コロナウイルス感染症の為、オンラインでの技術情報提供のセミナーを開催した。

日 時：令和4年3月17日(水) 14:00～16:30

場 所：オンライン

演 題：「広がり続けるダークシリコン

～最新半導体技術 と アプリケーション の動向～」

講 師：テカナリエ 代表取締役 CEO 清水 洋治 氏

参加者：84名

②おおいたテクノピッチの開催

大分県工業連合会と共催で、県内製造業の将来を担う人材確保につなげるため、県内企業が持つ優れた技術やものづくり産業の魅力を工業系学生に直接アピールする交流イベント「おおいたテクノピッチ」を開催した。

第1回目

日 時：令和3年9月30日(水) 14:30～16:00

個別交流 16:10～17:00

場 所：オンライン

参加企業：10社 (内 当会会員7社)

参加者：大分大学理工学部 創生工学科 機械コース 1年生 他

第2回目

日 時：令和3年11月17日(水) 14：40～16：10

場 所：大分県立工科短期大学校

参加企業：20社 (内 当会会員7社)

参加者：大分県立工科短期大学校1年生

機械システム系39名、建築システム系23名、

電気・電子システム系22名

③おおいた“産”観日の開催

大分県工業連合会と共催で、県内製造業の将来を担う人材確保につなげるため、県内企業が持つ優れた技術やものづくり産業の魅力を工業系学生に直接アピールする会社見学会「おおいた“産”観日」を開催した。

日 時：令和3年11月24日(水) 9：00～16：00

概 要：3コース

参加企業：12社 [機械：4社、建築：4社、電気・電子：4社]

(内 当会会員6社)

参加者：大分県立工科短期大学校 1年生

機械システム系39名、建築システム系20名、

電気・電子システム系16名

(3) 『災害時における相互協力に関する合意書』 登録会員拡大

概 要：災害時において会員の相互協力によって製品供給の継続に努め、顧客ひいては社会の発展に貢献できるよう参加会員にて合意した。

発行日：令和3年12月23日 (平成31年2月27日(水)初版)

合意会員：24社

第3号議案

令和3年度収支決算報告書

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	現計予算額 ①	決算額 ②	増減額 ②-①	備 考
1 負担金収入	44,370,000	44,370,000	0	大分県負担金
2 事業収入	400,000	400,000	0	
3 会費収入	850,000	850,000	0	85社 * 10,000円
4 雑収入	1,000	91	△ 909	預金利息
当期収入合計(A)	45,621,000	45,620,091	△ 909	
前期繰越金	731,000	731,664	664	
収入総合計(B)	46,352,000	46,351,755	△ 245	

支出の部

(単位:円)

科 目	現計予算額 ①	決算額 ②	増減額 ②-①	備 考
1 理事会・専門部会等開催費	417,000	200,460	△ 216,540	
理事会運営費	110,000	27,596	△ 82,404	2回開催
報酬	60,000	16,600	△ 43,400	
旅費	40,000	6,850	△ 33,150	
食糧費	10,000	4,146	△ 5,854	
専門部会・審査会等運営費	307,000	172,864	△ 134,136	
報酬	200,000	147,810	△ 52,190	
旅費	80,000	1,025	△ 78,975	
食糧費	27,000	24,029	△ 2,971	
2 総会・フォーラム開催費	1,013,000	1,010,970	△ 2,030	
総会運営費	831,000	830,830	△ 170	
印刷消耗費	170,000	169,950	△ 50	
委託料	263,000	262,900	△ 100	
使用料及び賃借料	398,000	397,980	△ 20	
フォーラム開催費	182,000	180,140	△ 1,860	
報償費	171,000	170,120	△ 880	
旅費	11,000	10,020	△ 980	
3 グローバルイノベーション事業費	13,686,000	13,503,304	△ 182,696	
研究開発・調査研究事業費	11,200,000	11,200,000	0	
負担金補助及び交付金	11,200,000	11,200,000	0	9件
半導体技術者基礎講座費	351,000	350,894	△ 106	
委託料	351,000	350,894	△ 106	
技術者研修会費	657,000	583,320	△ 73,680	
報償費	100,000	70,440	△ 29,560	
印刷消耗費	30,000	0	△ 30,000	
通信運搬費	7,000	0	△ 7,000	
委託料	520,000	512,880	△ 7,120	
グローバル人材養成講座費	742,000	692,630	△ 49,370	
報償費	100,000	97,640	△ 2,360	
印刷消耗費	30,000	0	△ 30,000	
通信運搬費	12,000	0	△ 12,000	
委託料	500,000	495,660	△ 4,340	
使用料及び賃借料	100,000	99,330	△ 670	
新分野・成長分野参入促進費	736,000	676,460	△ 59,540	
報償費	100,000	97,530	△ 2,470	
印刷消耗費	36,000	0	△ 36,000	
委託料	600,000	578,930	△ 21,070	

科 目	現計予算額 ①	決算額 ②	増減額 ②-①	備 考
4 グローバルマーケティング事業費	11,945,000	8,436,106	△ 3,508,894	
海外ビジネス交流事業費	4,395,000	2,047,180	△ 2,347,820	
報償費	120,000	108,550	△ 11,450	
旅費	1,375,000	0	△ 1,375,000	
食糧費	100,000	41,997	△ 58,003	
印刷消耗費	1,000,000	778,482	△ 221,518	
通信運搬費	500,000	24,138	△ 475,862	
委託料	500,000	361,900	△ 138,100	
使用料及び賃借料	700,000	634,700	△ 65,300	
備品購入費	100,000	97,413	△ 2,587	
展示会出展事業費	5,950,000	5,635,956	△ 314,044	
旅費	450,000	447,260	△ 2,740	
印刷消耗費	150,000	105,160	△ 44,840	
通信運搬費	450,000	435,820	△ 14,180	
委託料	1,500,000	1,412,396	△ 87,604	
使用料及び賃借料	3,400,000	3,235,320	△ 164,680	
販路開拓・拡大補助事業費	1,600,000	752,970	△ 847,030	
負担金補助及び交付金	1,600,000	752,970	△ 847,030	6件
5 グローバルネットワーク事業費	2,702,000	2,054,240	△ 647,760	
トップセミナー費	860,000	666,460	△ 193,540	
報償費	350,000	344,540	△ 5,460	
旅費	160,000	78,600	△ 81,400	
印刷消耗費	20,000	0	△ 20,000	
通信運搬費	10,000	0	△ 10,000	
使用料及び賃借料	320,000	243,320	△ 76,680	
産学・地域間交流事業費	440,000	287,120	△ 152,880	
報償費	100,000	84,330	△ 15,670	
食糧費	80,000	18,400	△ 61,600	
印刷消耗費	20,000	0	△ 20,000	
使用料及び賃借料	240,000	184,390	△ 55,610	
会員交流会費	1,402,000	1,100,660	△ 301,340	
印刷消耗費	661,000	660,000	△ 1,000	
委託料	441,000	440,660	△ 340	
使用料及び賃借料	300,000	0	△ 300,000	
6 事務局経費	16,589,000	15,251,658	△ 1,337,342	
LSIクラスターアドバイザー費	100,000	0	△ 100,000	
報償費	50,000	0	△ 50,000	
旅費	50,000	0	△ 50,000	
事務局長経費	6,000,000	5,681,864	△ 318,136	
負担金補助及び交付金	6,000,000	5,681,864	△ 318,136	
コーディネーター経費	6,800,000	6,466,188	△ 333,812	
報償費	1,800,000	1,771,730	△ 28,270	
負担金補助及び交付金	5,000,000	4,694,458	△ 305,542	
情報提供費	1,223,000	1,040,050	△ 182,950	
印刷消耗費	313,000	137,170	△ 175,830	
委託料	910,000	902,880	△ 7,120	
事務局運営費	2,466,000	2,063,556	△ 402,444	
旅費	150,000	103,552	△ 46,448	
食糧費	25,000	0	△ 25,000	
印刷消耗費	621,000	505,571	△ 115,429	
燃料費及び光熱水費	50,000	21,955	△ 28,045	
通信運搬費	150,000	114,725	△ 35,275	
手数料	500,000	438,988	△ 61,012	
使用料及び賃借料	600,000	569,202	△ 30,798	
負担金補助及び交付金	370,000	309,563	△ 60,437	
当期支出合計(C)	46,352,000	40,456,738	△ 5,895,262	
当期支出差額(B)-(C)	0	5,895,017	5,895,017	